

## Borneras de la CIAA

Documento para analizar las borneras actuales de la CIAA (NXP) y la propuesta para la versión FSL.

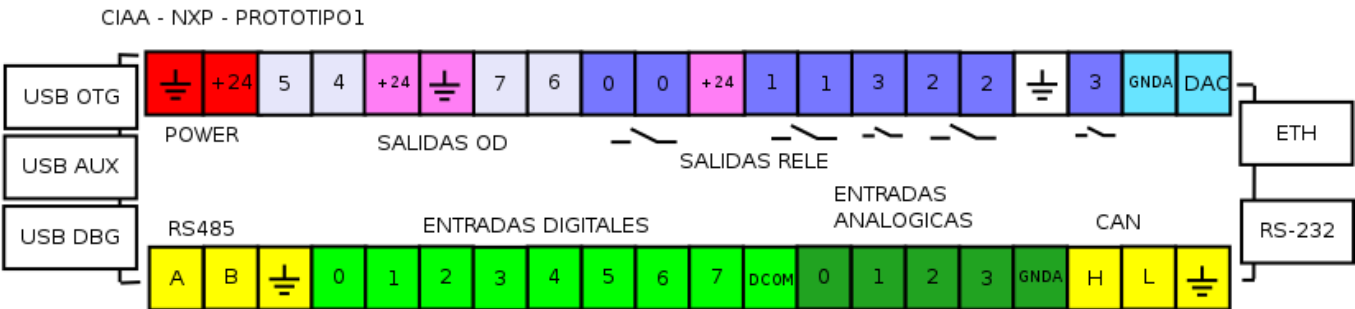
### Compatibilidad entre CIAAs

Para mantener un nivel de compatibilidad entre versiones de las CIAAs se propone:

- Que sea obligatorio la marcación de bornes en PCB y en gabinete para cualquier versión.
- Que se incluya la distribución de borneras en el set básico de documentación de cada CIAA.
- Separar conceptualmente la alimentación. Se hace agregando un conector usado de chassis ground, aunque este no este implementado como tal.

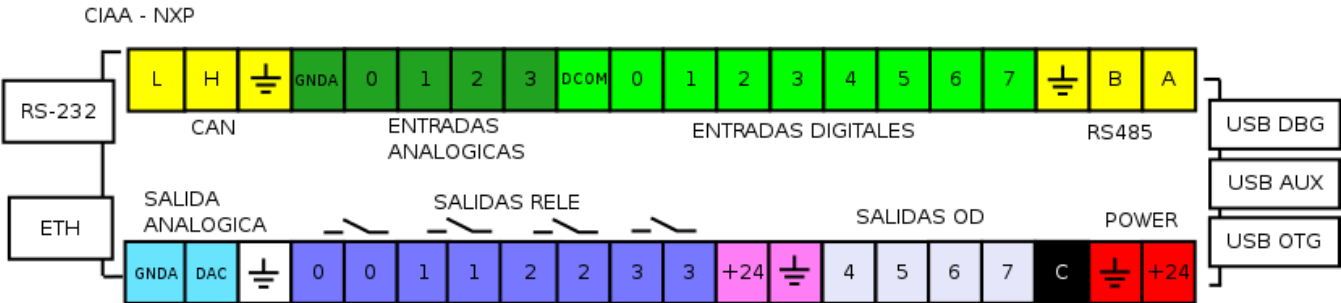
### Borneras CIAA-NXP

La distribución del primer prototipo de la CIAA-NXP es la siguiente:



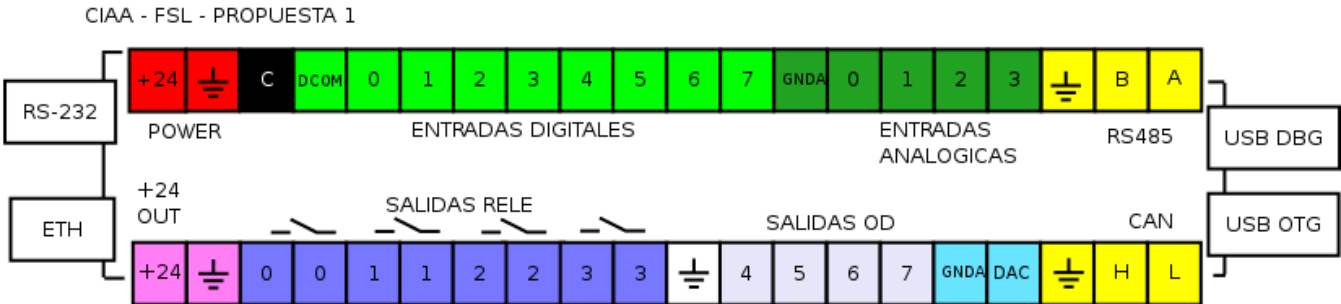
Puede observarse, en la distribución del prototipo 1, que las salidas no tienen una distribución organizada para un posible usuario. Será recomendable hacer cambios mínimos para conseguir una distribución más uniforme. Los cambios serían:

- Considerar girado 180 grados el diseño cuando se lo documenta.
- Eliminar una salida de 24V de las borneras de salida.
- Dejar una bornera para la conexión de chassis al lado de la entrada de alimentación.
- Renumerar (desde esquemático) el número de cada bornera para lograr numeraciones consecutivas y cambios menores de orden (adyacentes).



### Borneras CIAA-FSL

De acuerdo al relevamiento de PLCs realizado, y buscando compatibilidad e nivel de bloques, la opción que proponemos para la CIAA-FSL es la siguiente:



Esta distribución nos parece la más adecuada buscando un compromiso entre ruteo, usuario final y compatibilidad con la versión NXP. Esta distribución se ha trabajado de a bloques idénticos a la CIAA-NXP para que mediante el uso de Borneras desmontables en bloques, pueda pasarse de un equipo a otro sin mayores problemas.